

Title (en)
METHOD FOR SEALING ELECTRICAL DEVICES.

Title (de)
VERFAHREN ZUM ABDICHTEN ELEKTRISCHER EINRICHTUNGEN.

Title (fr)
PROCEDE POUR ETANCHEISER LES DISPOSITIFS ELECTRIQUES.

Publication
EP 0232256 A1 19870819 (EN)

Application
EP 85904047 A 19850809

Priority
US 8501497 W 19850809

Abstract (en)
[origin: WO8700983A1] A method of sealing electrical fittings. The method comprises foaming in situ a removable, flame retardant, solvent resistant, substantially closed cell isocyanurate foam. The isocyanurate foam is prepared from a two-part, liquid, foamable, curable composition, the parts being mixed at the time of application, the composition comprising, in a first part, a prereaction product of an isocyanate and a polyol, and, in a second part, catalyst, chain extending agent, flame retardant agent, and blowing agent. Also provided are an electrical fitting and cable duct or riser sealed with the isocyanurate foam.

Abstract (fr)
Procédé comportant la préparation sur place d'une mousse d'isocyanurate ignifuge pouvant être enlevée, résistante aux solvants et à cellules essentiellement fermées. La mousse d'isocyanurate est obtenue à partir d'une composition en deux parties, qui est liquide, moussante et polymérisable, les parties étant mélangées au moment de l'application de la mousse. La composition comporte, dans une première partie, un produit de pré réaction d'un isocyanate et d'un polyol, et dans une deuxième partie un catalyseur, un agent d'allongement de chaîne, un agent ignifuge et un agent de soufflage. Sont également prévus une garniture électrique et une gaine de câble ou un tube vertical rendus étanches par la mousse d'isocyanurate.

IPC 1-7
H02G 3/06; C08G 18/79

IPC 8 full level
A62C 2/00 (2006.01); **A62C 3/16** (2006.01); **C08G 18/02** (2006.01); **H02G 3/00** (2006.01); **H02G 3/06** (2006.01); **H02G 3/08** (2006.01)

CPC (source: EP)
H02G 3/06 (2013.01)

Citation (search report)
See references of WO 8700983A1

Designated contracting state (EPC)
CH DE FR GB IT LI SE

DOCDB simple family (publication)
WO 8700983 A1 19870212; EP 0232256 A1 19870819; JP S63500490 A 19880218

DOCDB simple family (application)
US 8501497 W 19850809; EP 85904047 A 19850809; JP 50363385 A 19850809